

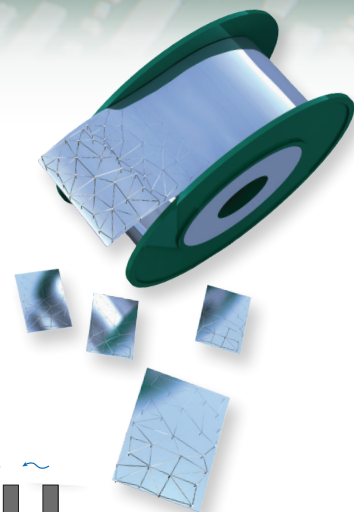
功率电子材料

无缺陷 更可靠

各行各业都开始要求功率电子设备输出更高的功率。

随着这一趋势的发展，持续开发材料至关重要。

这些材料要能满足功率电子设备在散热、空洞及全方位可靠性方面的需要。

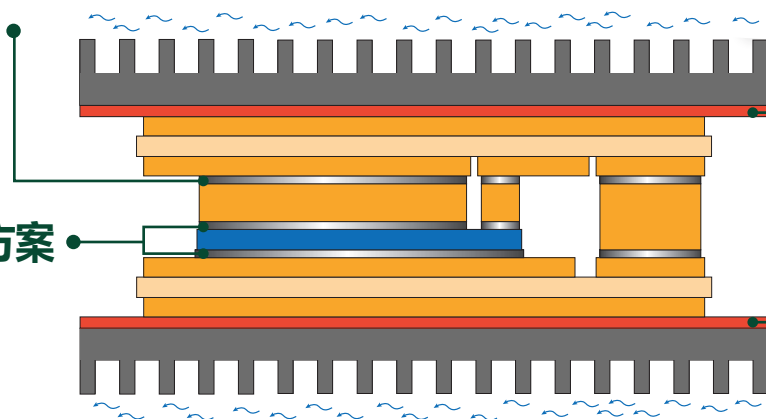


基板/附加垫片的焊接解决方案

- 均匀的焊接层厚度
- 低空洞率

芯片粘接的解决方案

- 均匀的焊接层厚度
- 可靠的间隙高度



散热解决方案

- 低热阻
- 无烘干或者抽干

成熟的焊接层控制

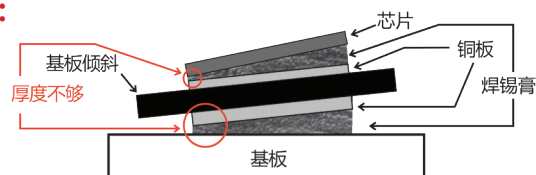
InFORMS®

预成型焊片及焊带*

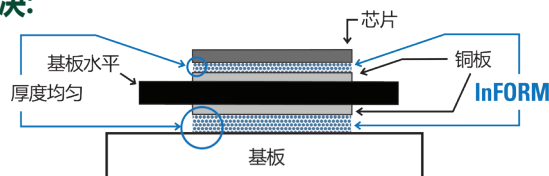
- 可靠性提高2倍以上 (-55/+150° C) 经过3500个热循环
- 最均匀的焊接层控制
- 省却了昂贵的引线键合修整过程
- 更高的强度及可靠的间隙高度
- 低空洞率
- 整体成本最低

*专利申请中

问题:



已解决:



联系我们的工程师: china@indium.com

更多: www.indiumchina.cn

From One Engineer To Another®

钢泰公司的所有焊锡膏和预成型焊片的生产工厂均通过IATF 16949: 2016认证。钢泰公司是ISO 9001: 2015注册公司。

©2020 钢泰公司

表格编号: 99800 (SC A4) R0



功率电子材料 无缺陷 更可靠

成熟的快速烧结技术

QuickSinter® 新

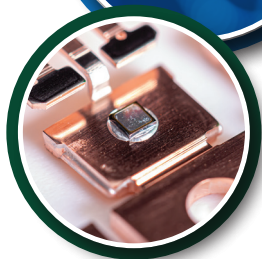
银烧结膏

- 优异的焊点强度
- 可用于加压应用的无压烧结解决方案
- 可控的焊接层厚度30-70μm
- 烧结回流曲线窗口宽
- 空洞率: <1%*
- 气孔率: <30%*

*取平均值

>3点/秒

均匀而高速的点胶



高性能

金属导热界面解决方案

无抽干或烘干

- Heat-Spring®
- HSP
- HSMF
- 液态金属
- m2TIM™



独家Au80Sn20焊片

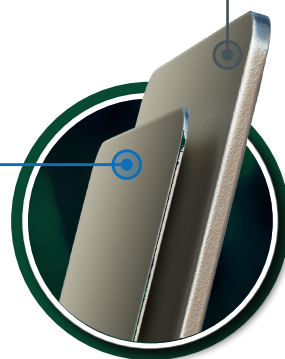
AuLTRA™ ThInFORMS™ 新

- 金-锡预成型焊片，用于芯片粘接应用
- 提供超薄尺寸：0.00889mm (0.00035英寸)
- 改善热传递和整体操作效率
- 减少空洞、焊锡膏用量及毛细作用

0.0508mm

典型的芯片粘接预成型焊片

0.00889mm
AuLTRA™ ThInFORMS™



功率半导体的其他可用产品

- LV1000镀层型焊片
- Indium3.2HF焊锡膏
- 预成型焊片
- 更多...

联系我们的工程师: china@indium.com

更多: www.indiumchina.cn

From One Engineer To Another®

钢泰公司的所有焊锡膏和预成型焊片的生产工厂均通过IATF 16949: 2016认证。
钢泰公司是ISO 9001: 2015注册公司。

©2020 钢泰公司

表格编号: 99800 (SC A4) R0



INDIUM
CORPORATION®
钢泰公司